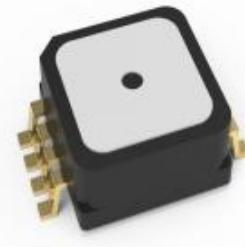


## HBP1302D-2系列压力传感器模组

### 产品特性

- 硅压阻式MEMS技术、高灵敏度、高稳定性
- 测量范围：10kPa ~ +2000kPa量程可选，绝压
- 供电电压：1.8V ~ 5.5V可选
- 数字I<sup>2</sup>C输出
- SOP8封装方式，易于使用
- 适用于非腐蚀性气体或液体



### 典型应用

- 胎压计、MAP传感器、车载气泵、刹车助力等汽车电子领域
- 洗衣机、热水器、咖啡机、净水机、啤酒机等智能家电领域
- 空气泵、空压机、真空泵、压力仪表等工业压力控制
- 水压测量、潜水设备等绝压系统

### 产品概述

HBP1302D-2 产品系列是豪帮高科推出的集成度高、稳定性好、可靠性优异的压力传感器模组。该产品由 MEMS 压力传感器芯片和高性能的调理电路组成。存储在 OTP 中的校准系数数据可用于产品的校准，压力校准和温度补偿由测试系统自动实现，校准后的压力和温度以数字 I<sup>2</sup>C 形式输出。HBP1302D-2 采用 SOP8 封装形式，结构紧凑，客户使用方便，并能保证产品高性能、高稳定性和高可靠性的压力测量。产品适用于非腐蚀性气体的差压检测，在智能家电、工业控制及汽车电子等领域具有广泛应用前景。图 1 是 HBP1302D-2 产品原理框图。

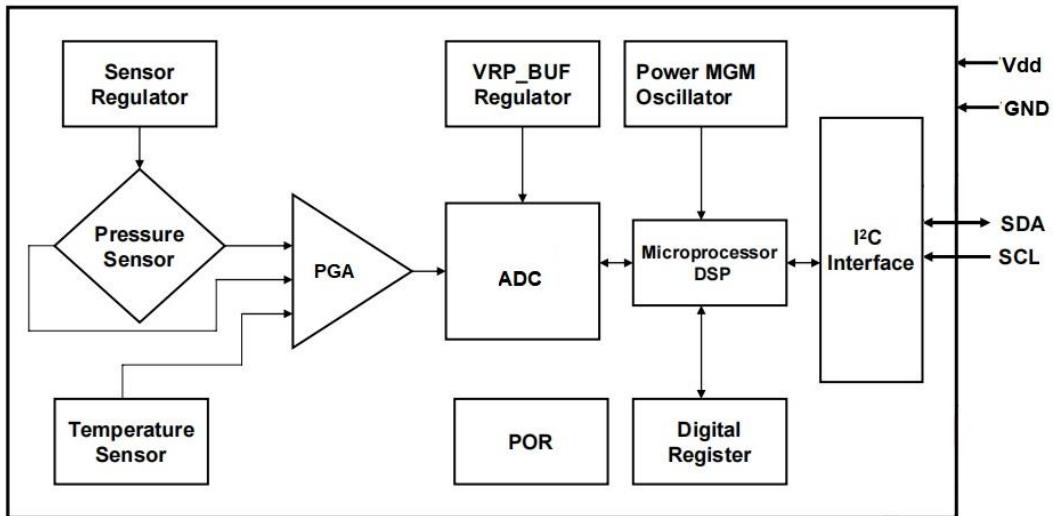


图 1：HBP1302D-2 产品框图

## 绝对最大额定值\*

表 1：HBP1302D-2 产品系列绝对最大额定值

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压		-0.3		6.5	V
数字端电压	25°C	-0.3		Vdd+0.3	V
过载压力			2 倍		额定压力
爆破压力			3 倍		额定压力
ESD	HBM		±2		kV
存储温度		-40		125	°C
介质		非腐蚀性气体			

\*请注意：超过“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力额定值，并不意味着器件在这些或任何其他条件下的功能操作超出了“推荐工作条件下”所示的条件。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

## 基本性能指标

表 2：HBP1302D-2 产品系列基本性能

性能参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
测量范围	10		2000	kPa	绝压
供电电压	1.8	5.0	5.5	V	
静态电流		100	200	nA	
精度		±1		%FS	
响应时间		2.5		ms	
分辨率			24	Bits	
零点温度漂移		±0.035		%FS/°C	
满程温度漂移		±0.035		%FS/°C	
工作温度	-20	0-60	85	°C	温度可选
补偿温度	0	0-60	85	°C	补偿温度可选

**请注意：**除非另有说明，上表中的数据在如下条件测试所得：测量介质为空气；大气压(101325±500)Pa；温度(25±2)°C；振动<0.1g(1m/s<sup>2</sup>)；湿度(50%±10%)RH；电压(5.0±0.25)V。

## I<sup>2</sup>C 通讯协议

I<sup>2</sup>C 总线使用 SCL 和 SDA 作为信号线，这两根线都通过上拉电阻（典型值 4.7KΩ）连接到 Vddio，这样使得空闲状态都保持为高电平。A7~A1 位组成从机的地址，W/R 位是数据传送方向位，0 表示主机向从机写数据，1 表示主机由从机读数据，如表 3 所示。

表 3：I<sup>2</sup>C 地址

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	W/R
1	1	0	1	1	0	1	0/1

表 4：内部寄存器信息

地址	描述	读写	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	默认值				
0x00	SPI_Ctrl	RW	SDO_active	LSB_first	Soft reset			Soft reset	LSB_first	SDO_active	0x00				
0x01	Part_ID	R			PartID<7:0>			0x00							
0x02	Status	R		Error_code<5:0>		1'b0		DRDY		0x00					
0x06	DATA_MSB	R			Data out<23:16>			0x00							
0x07	DATA_CSB	R			Data out<15:8>			0x00							
0x08	DATA_LSB	R			Data out<7:0>			0x00							
0x09	TEMP_MSB	R			Temp out<15:8>			0x00							
0x0A	TEMP_LSB	R			Temp out<7:0>			0x00							
0x30	CMD	RW		Sleep_time<3:0>		Sco		Measurement_ctrl<2:0>		0x00					
0x6C	OTP_CMD	RW		Blow_start<6:0>			margin			0x00					

读取数据按照如下指令顺序进行操作：

1. 读取0xA5寄存器值，将读取到的二进制值“与”上“11111101”后再写入0xA5。
2. 发送指令0x0A到0x30寄存器进行一次温度采集，一次压力数据采集。
3. 读取0x30寄存器地址，若Sco位为0代表采集结束，可以读取数据，或等待延迟10ms

(10ms适用于OSR\_P范围在256X~4096X)。

4. 读取0x06、0x07、0x08三个寄存器地址数据构成24位AD值（压力数据AD值）。
5. 将读取到的24位AD值进行如下操作计算出最终压力输出： $OUT(Pa)=AD/2^{23}*Fullscal$ 。

注意Fullscal的取值：

eg：当满量程压力为600000Pa时， $2^{19} < 600000 < 2^{20}$ ,在24位AD中最少需要20位来表示，即此时Fullscal取 $2^{20}$ 。

电路内部寄存器请参考如上表4。

其中REG0x06、REG0x07、REG0x08寄存器内为压力输出值共计24位，其中最高位为符号位，符号位数值为“1”时代表“负”，符号位数值为“0”时代表“正”。REG0x09、REG0x0A寄存器内为温度输出数值共计16位，其中最高位为符号位，符号位数值为“1”时代表“负”，符号位数值为“0”时代表“正”。I<sup>2</sup>C通讯时序值如表5所示。

表 5：I<sup>2</sup>C 通讯时序值

符号	参数	最小值	最大值	单位
f <sub>scl</sub>	时钟频率		400	KHz
t <sub>LOW</sub>	SCL低脉冲时间	1.3		μs
t <sub>HIGH</sub>	SCL高脉冲时间	0.6		μs
t <sub>SUDAT</sub>	SDA建立时间	0.1		μs
t <sub>HDDAT</sub>	SDA保持时间	0		μs
t <sub>SUSTA</sub>	重复启动条件的建立时间	0.6		μs
t <sub>HDSTA</sub>	启动条件的保持时间	0.6		μs

$t_{SUSTO}$	停止条件的建立时间	0.6		$\mu s$
$t_{BUF}$	新的传输之前的开始时间	1.3		$\mu s$

例如假设REG0x06、REG0x07、REG0x08、REG0x09、REG0x0A读出的十进制值为x、y、

z、a、b。

压力cal\_AD值：  $m=x*2^{16}+y*2^8+z$

正负处理：若  $m>2^{23}$ ，则是一个负值，压力值= $(m-2^{24})/2^{23}*\text{Fullscal}$  (Pa)

若  $m<2^{23}$ ，则是一个正值，压力值= $m/2^{23}*\text{Fullscal}$  (Pa)

温度值：  $n=a*2^8+b$

正负处理：若  $n>2^{15}$ ，则是一个负值，温度值= $(n-2^{16})/256$ ; ( $^{\circ}\text{C}$ )

若  $n<2^{15}$ ，则是一个正值，温度值= $n/256$ ; ( $^{\circ}\text{C}$ )。

## I<sup>2</sup>C时序

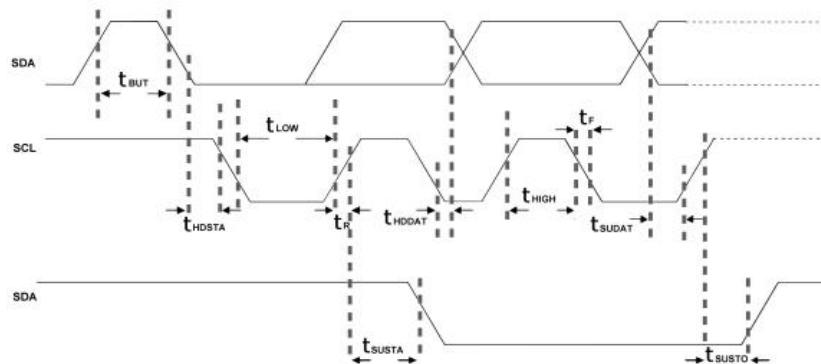


图 2：参考电路 I<sup>2</sup>C 通讯时序图

图 2 是参考电路 I<sup>2</sup>C 的时序图。从设备应答后，主设备继续发送 8 位寄存器地址，得到应答后继续发送或读取数据。SCL 处于高电平，SDA 发生一个上升沿动作标志 I<sup>2</sup>C 通信结束。除了开始和结束标志之外，当 SCL 为高时 SDA 传输的数据必须保持稳定。当 SCL 为低时 SDA 传输的值可以改变。I<sup>2</sup>C 通信中的所有数据传输以 8 位为基本单位，每 8 位数据

传输之后需要一位应答信号以保持继续传输。

### I<sup>2</sup>C 协议数据传输

在启动条件下 Start(S), SCL 是高电平时，SDA 由高电平到低电平的变化，代表开始。在停止条件下 Stop(P)，SCL 依然为高电平时，SDA 由低电平到高电平变化，代表停止。起始和终止信号都是由主机发出，起始信号产生后，总线处于被占用状态，在终止信号产生后，总线就处于空闲状态，如图 3 所示。

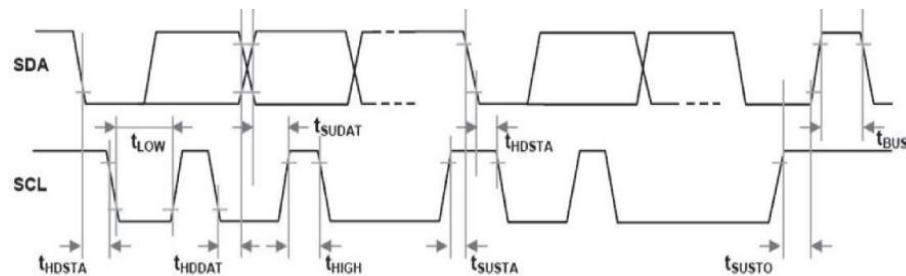


图 3：参考电路 I<sup>2</sup>C 协议数据传输时序图

### 参考应用电路

图 4 是 HBP1302D-2 的参考应用电路。

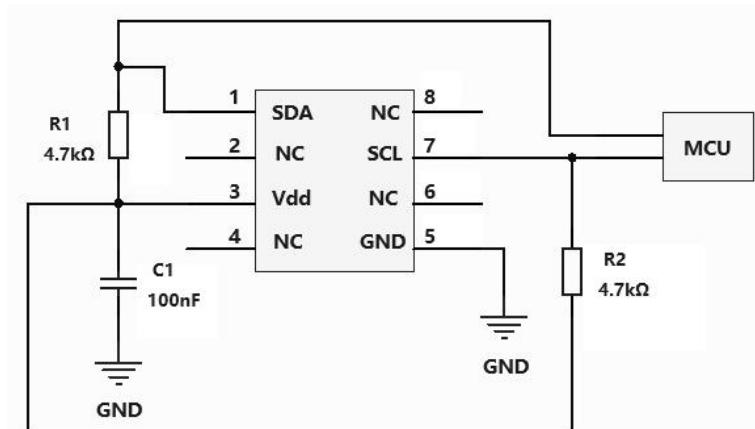


图 4：参考应用电路

## 封装尺寸

HBP1302D-2 产品系列封装尺寸如下图 5，所有尺寸单位均为毫米(mm)，未标注公差均为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

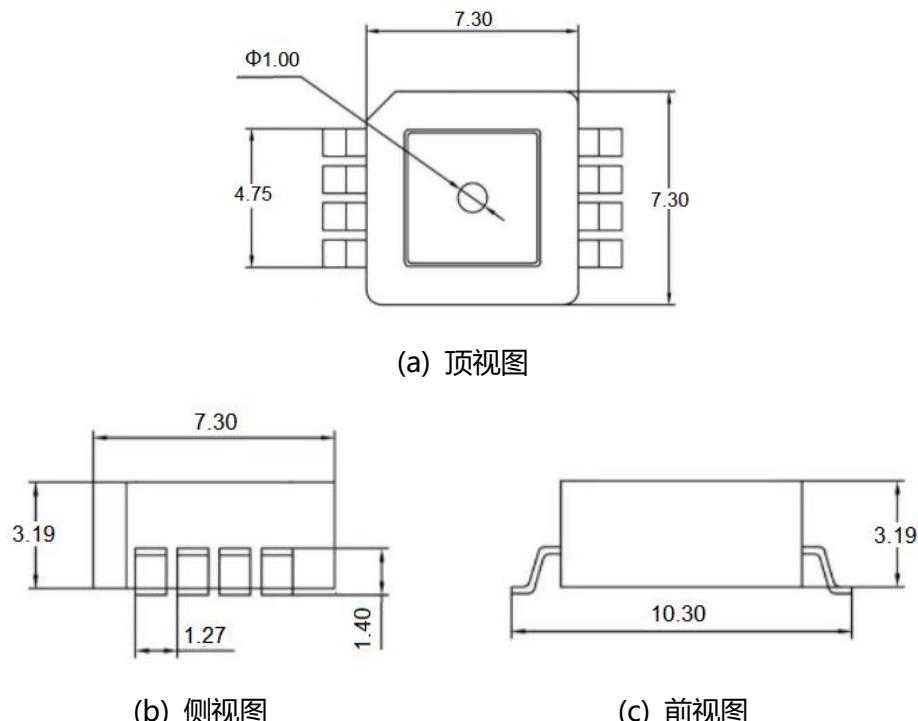


图 5：封装尺寸图

## 引脚定义及功能描述

HBP1302D-2 产品系列的引脚定义请参考图 6，其引脚功能描述请参考表 6。

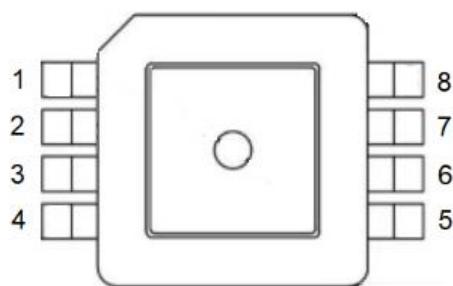


图 6：引脚定义图

表 6：引脚功能描述

引脚编号	1	2, 4, 6, 8	3	5	7
定义	SDA	NC	Vdd	GND	SCL
功能	数据信号	空	供电正极	地	时钟信号

**请注意：**

- 1) 任何电信号不要连到 NC 脚，否则可能会引起部分功能失效。
- 2) 焊装过程中做好防静电保护。
- 3) 过载电压(6.5VDC)可能烧毁电路芯片，请在 Vdd 和 GND 之间加上 0.1uf 电容。
- 4) 本产品无反接保护，装配时请注意电源极性。

## 参考回流曲线

HBP1302D-2 产品系列 SMT 回流焊的温度曲线请参看图 7，回流焊的工艺参数说明请参考表 7。

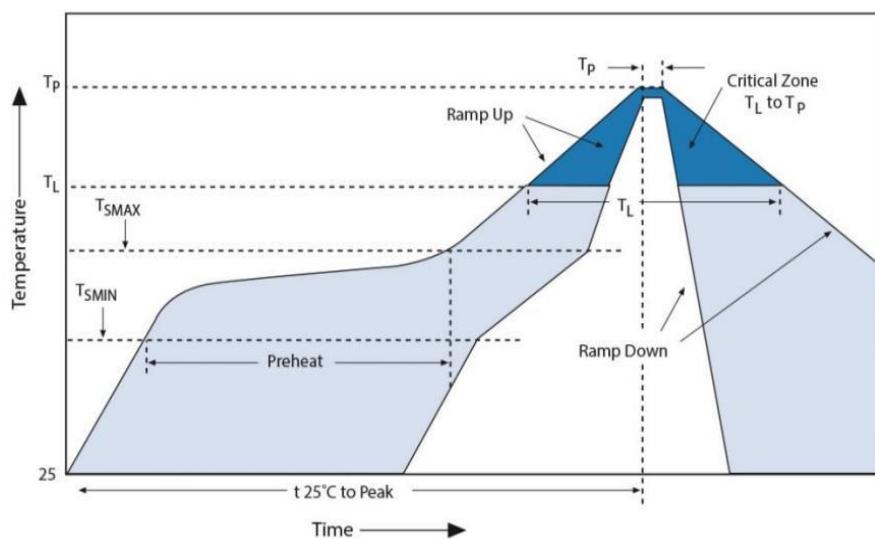


图 7：回流焊温度曲线

表 7：回流焊参数说明

曲线特征	无铅
平均加热速率 (TSMAX 到 TP)	最快 3°C/秒
预热区最低温度(TSMIN)	150°C
预热区最高温度(TS MAX)	200°C
TSMIN 到 TS MAX (tS)	60~180 秒
回流区温度(TL)	217°C
回流区时间(tL)	60~150 秒
峰值温度 (TP)	260°C
峰值温度 +/- 5°C 保持时间(tP)	20~40 秒
下降速度 (TP to TS MAX)	最大 6°C/秒
从 25°C 到峰值温度的时间	最长 8 分钟

**请注意：**

- 1) 传感器芯片上不允许落入灰尘中，以免影响产品性能。
- 2) 回流焊后清洗时，避免清洗剂或清洁剂侵入内部损坏产品。请不要将产品暴露在超声波处理或清洁，避免产品发生故障。
- 3) 建议回流焊次数不超过 3 次。

## 产品选型信息\*

HBP1302D-2 产品系列选型信息如图 8 所示。

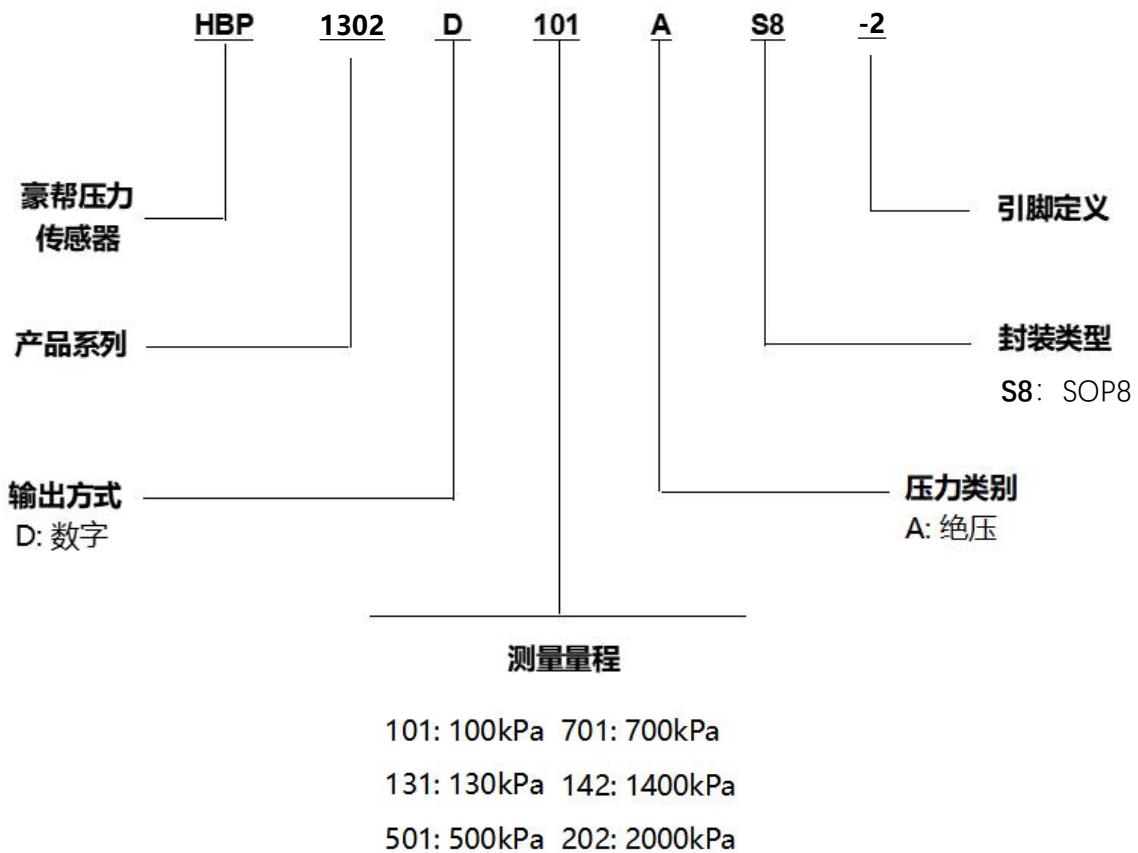


图 8：产品选型指南图

### \*请注意：

- 1) 部分产品不包含以上所述的所有量程，如需更多产品信息，请联系豪帮销售人员。
- 2) 压力换算： $10\text{kPa}=100\text{hPa}=100\text{mBar}\approx75\text{mmHg}\approx100\text{mmH}_2\text{O}\approx1.45\text{PSI}$

表 8：常用量程表

压力量程 (kPa)	型号
10 ~ 100	HBP1302D101AS8-2
10 ~ 150	HBP1302D151AS8-2
10 ~ 200	HBP1302D201AS8-2
10 ~ 500	HBP1302D501AS8-2
10 ~ 700	HBP1302D701AS8-2
10 ~ 1000	HBP1302D102AS8-2
10 ~ 1400	HBP1302D142AS8-2
10 ~ 1500	HBP1302D152AS8-2
10 ~ 2000	HBP1302D202AS8-2

## 定制服务

豪帮切实以客户需求为导向，为客户提供灵活定制方案，以满足客户不同需求。提供包括但不限于不同量程、不同封装尺寸、不同应用范围的压力传感器器件和压力传感器模组等有效定制服务。如需了解更多信息，敬请联系 [info@haobang-smt.com](mailto:info@haobang-smt.com)。

## **版本修订记录**

表 9：版本修订记录

版本	描述	日期
1.0	首次发行	2025 年 2 月